

证券代码：688401

证券简称：路维光电

转债代码：118056

转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	路维光电 2025 年半年度业绩说明会
调研时间	2025 年 8 月 26 日
会议地点	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁：杜武兵 董事、执行总裁、董事会秘书：肖青 董事、财务总监：刘鹏 独立董事：李玉周
投资者关系 活动内容记 录	<p>1、公司对江苏路芯半导体技术有限公司投资布局 28nm 半导体掩膜版项目，计划在 2025 - 2027 年推进相关建设。想了解一下目前该项目的实际进展情况如何？</p> <p>您好。公司投资建设的路芯半导体掩膜版项目进展顺利，制程节点布局居于国内厂商前列。项目一期覆盖 130-40nm 制程节点半导体掩膜版。报告期内，一期项目的电子束光刻机等主要设备已陆续到厂并有序投入生产，90nm 及以上半导体掩膜版已向客户陆续送样并获部分客户验证通过。依据规划，2025 年下半年将启动 40nm 半导体掩膜版试生产工作。目前一期项目的部分后段设备具备 28nm 制程节点</p>

	<p>半导体掩膜版的生产能力，二期项目购置 28nm 电子束光刻机等相关生产设备后即可量产 28nm 制程节点的半导体掩膜版。未来伴随一、二期项目的顺利投产，公司产品将陆续覆盖 MCU（微控制芯片），SiPh（硅光子）、CIS（互补金属氧化物半导体图像传感器），BCD（双极-互补-双扩散-金属氧化物半场效应管），DDIC（显示驱动芯片），MS/RF（混合射频信号），Embd. NVM（嵌入式非易失存储器），NOR/NAND Flash（非易失闪存）等半导体制造相关行业，进一步完善产业链供给、推动国产替代进程。感谢您的关注！</p> <p>2、随着行业竞争加剧，公司有哪些具体应对策略和差异化竞争优势来保障业务持续稳定增长？</p> <p>您好，行业竞争是企业经营中持续遇到的问题，公司经过近 30 年的发展，已构筑了自己的核心技术体系，产品技术多次打破海外垄断。公司长期以来专注于掩膜版的技术研发，形成了系统化、规范化、科学化的研发体系，拥有一支高素质的研发团队，可以进行前瞻性的研发积累以及快速的市场需求响应；此外，公司一直紧跟平板显示、半导体等下游行业的发展动态，与下游平板显示、半导体行业知名企业建立了良好的沟通和战略合作，积累了丰富的行业经验，公司凭借稳定的产品质量和优秀的客户服务积累了一大批优质、稳定的客户群体。伴随公司的产能和技术持续提升，公司可满足更多下游客户的需求，促进公司业务持续稳定增长。感谢您的关注！</p> <p>3、公司 2025 年上半年营业收入同比增长 37.48%，归母净利润同比增长 29.13%。营收增长主要是由哪些产品或业务板块拉动的？</p> <p>您好。根据下游行业划分产品，2025 年上半年公司平板显示掩膜版与半导体掩膜版均实现了良好的增长态势；其中 OLED 用掩膜版的增速明显，带动平板显示掩膜版的结构改善与盈利能力提升；半导体方面，IC 制造掩膜版、IC 器件掩膜版增速较快。随着各扩产项目产能的陆续释放，公司预计半导体掩膜版、平板显示掩膜版的收入将进一步提升，实现双轮驱动发展。感谢您的关注！</p>
关于本次活	本次活动不涉及应当披露重大信息。

动是否涉及应当披露重大信息的说明	
风险提示	以上内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单	无